PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11067490 A

(43) Date of publication of application: 09.03.99

(51) Int. Ci

H05H 1/00 B01J 19/08 H01L 21/3065 H05H 1/46

(21) Application number: 09233351

(22) Date of filing: 14.08.97

(71) Applicant:

GOTO TOSHIO NIPPON LASER

ı

DENSHI KK

(72) Inventor:

GOTO TOSHIO HORI MASARU

(54) ABSOLUTE VALUE DENSITY OUTPUT DEVICE FOR CARBON RADICAL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To control a carbon radical with high accuracy by outputting the absolute value density of a carbon radical in a crude gas after operating it from an absorption coefficient calculated based on the absorption factor of the carbon radical measured from the outgoing amount and the transmission in the crude gas of carbon radical rays having a specific wave length and Einstein's A coefficient for a specific wave length.

SOLUTION: The wave length of carbon radical rays is 296.7 nm. Einstein's A coefficient is $4.7\times10^4\mathrm{S}^{-1}$. The absorption coefficient is calculated from formula I [in the formula, I_a/I_0 represents the absorption factor, f_1 (ν) represents the profile of the carbon radical, f_2 (ν) represents the absorption profile of the carbon radical in plasma, ν represents a frequency, L represents an absorption length and K_0 represents the absorption coefficient at the center frequency]. The absolute density is calculated from formula II [in the formula, ν_0 represents the center frequency, g_1 represents a statistical weight factor of the lower level, g_2 represents a statistical weight factor of the

represents the density of the lower level and A represents Einstein's A coefficient and however, g_1 = g_2 =5 if the wave length of the carbon radical is 296.7 nm].

upper level, C represents the light velocity,

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

$$\frac{I_{1}}{I_{0}} = \frac{\int f_{1}(\mathbf{v}) \, e \, \mathbf{x} \, p \{-k_{0}L^{0} \, f_{2}(\mathbf{v})\} \, d\mathbf{v}}{\int f_{1}(\mathbf{v}) \, d\mathbf{v}}$$

$$N = \frac{8 \pi v_0^2 g_1}{A C^2 g_2} \int k_0 f_3(v) dv$$

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-67490

(43)公開日 平成11年(1999) 3月9日

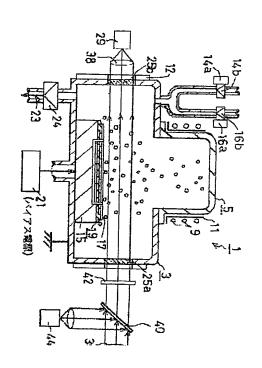
F H 1/00					
H05H 1/00 A B01J 19/08 H01L 21/3065 H05H 1/46 A H01L 21/302 E 審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 11 頁) (21)出願番号 特願平9-233351 (71)出願人 591074172 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (71)出願人 000230467 日本レーザ電子株式会社 名古屋市熱田区三本松町20番9号 (72)発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市五色園 3 -2110 (72)発明者 堀 勝			FI		
B 0 1 J 19/08 H 0 1 L 21/3065 H 0 5 H 1/46 H 0 1 L 21/302 審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 11 頁) (21)出願番号 特願平9-233351 (71)出願人 591074172 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (71)出願人 000230467 日本レーザ電子株式会社 名古屋市熟田区三本松町20番 9 号 (72)発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市五色園 3 -2110 (72)発明者 堀 勝			H05H 1/00	Α	
H 0 5 H 1/46 H 0 1 L 21/302 E 審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 11 頁) (21)出願番号 特願平9-233351 (71)出願人 591074172 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (71)出願人 000230467 日本レーザ電子株式会社 名古屋市熟田区三本松町20番9号 (72)発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市五色園 3 -2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33			B 0 1 J 19/08	- -	
審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 11 頁) (21)出願番号 特願平9-233351 (71)出願人 591074172 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (71)出願人 000230467 日本レーザ電子株式会社 名古屋市熱田区三本松町20番9号 (72)発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33			H05H 1/46	A	
(21) 出願番号 特願平9-233351 (71) 出願人 591074172 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3-2110 (71) 出願人 000230467 日本レーザ電子株式会社 名古屋市熱田区三本松町20番 9 号 (72) 発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3-2110 (72) 発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33	HUSH I/	46	H 0 1 L 21/302	E	
(22)出願日 平成9年(1997)8月14日 受知県日進市五色園3-2110 (71)出願人 000230467 日本レーザ電子株式会社 名古屋市熱田区三本松町20番9号 (72)発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園3-2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33			審査請求 未請求 請求	R項の数10 FD (全 11 頁)	
平成9年(1997) 8月14日 愛知県日進市五色園 3 -2110 (71)出願人 000230467 日本レーザ電子株式会社 名古屋市熱田区三本松町20番9号 (72)発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 -2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33	(21)出願番号	特願平9-233351	(71)出願人 591074172		
日本レーザ電子株式会社 名古屋市熱田区三本松町20番9号 (72)発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 - 2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33	(22)出願日	平成9年(1997)8月14日	愛知県日進市	愛知県日進市五色園 3 -2110	
(72)発明者 後藤 俊夫 愛知県日進市五色園 3 - 2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33			日本レーザ電		
愛知県日進市五色園 3 - 2110 (72)発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33					
(72)発明者 堀 勝 愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33			i i		
愛知県日進市折戸町藤塚105番地の33				7五色園 3 -2110	
			1	折戸町藤塚105乗州の22	

(54) [発明の名称] 炭素ラジカルの絶対値密度出力装置

(57)【要約】

【課題】炭素原子を含んだ原料ガス中における炭素ラジカルを絶対値で出力して確認可能にする炭素ラジカルの 絶対値密度出力装置の提供。

【解決手段】容器内に導入される炭素原子を含んだ原料ガスに対し、発光線発生装置から波長296.7 nmの炭素ラジカル光線を照射し、炭素ラジカル光線の出射量と原料ガス中を透過した炭素ラジカル光線の透過量から算出された炭素ラジカルの吸収率により式1を基づいて吸収係数を算出する。該吸収係数と波長296.7 nmの炭素ラジカル光線の放射減衰率であるアインシュタインA係数から式2に基づいて炭素ラジカルの絶対値密度を演算し、出力手段へ出力して確認可能にする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】容器内に導入される炭素原子を含んだ原料ガスに対し、発光線発生装置から波長296.7nmの炭素ラジカル光線を照射して炭素ラジカル光線の出射量と原料ガス中を透過した炭素ラジカル光線の透過量により測定した炭素ラジカルの吸収率から下記式1により吸収係数を算出し、該吸収係数及び波長296.7nmの

アインシュタインA係数: 4. 7×104 S⁻¹から下記式2により原料ガス中における炭素ラジカルの絶対値密度を演算する絶対値密度演算手段と、演算された炭素ラジカル密度を絶対値として出力する出力手段とを備えた炭素ラジカルの絶対値密度出力装置。

【式1】

$$\frac{I_{t}}{I_{0}} = \frac{\int f_{1}(v) e x p \{-k_{0}L \cdot f_{2}(v)\} dv}{\int f_{1}(v) dv}$$

 I_a / I_0 :吸収率、 f_1 (ν):炭素ラジカルのプロファイル f_2 (ν):プラズマ中の炭素ラジカルの吸収プロファイル、

ν:周波数、L:吸収長、kn:中心周波数の吸収係数

【式2】

$$N = \frac{8 \pi v_0^2 g_1}{A C^2 g_2} \int k_0 f_2(v) dv$$

ν₀ : 中心周波数、g₁ : 下準位の統計重率、

g2:上準位の統計重率、c:光速、

N:下準位の密度、A:アインシュタインA係数

但し、炭素ラジカル光線が296.7nm の場合、 $g_1 = g_2 = 5$

【請求項2】請求項1において、出力手段は表示装置からなり、該表示装置に演算された炭素ラジカルの絶対値密度を表示する炭素ラジカルの絶対値密度出力装置。

【請求項3】請求項1において、出力手段は印字装置からなり、該印字装置により演算された炭素ラジカルの絶対値密度出力装 でである炭素ラジカルの絶対値密度出力装 置。

【請求項4】請求項1において、容器内には陰及び陽電極を配置し、該電極間に電力を印加して導入された原料ガスをプラズマ化して炭素ラジカルを発生させる炭素ラジカルの絶対値密度出力装置。

【請求項5】請求項1又は4において、絶対値密度演算手段からの絶対値密度データに基づいて容器内に導入される原料ガス量を制御する制御手段を設けた炭素ラジカルの絶対値密度出力装置。

【請求項6】請求項4において、演算された炭素ラジカルの絶対値密度に基づいて容器内からの排気を可変して 導入された原料ガスの圧力を調整可能にする制御手段を 設けた炭素ラジカルの絶対値密度出力装置。

【請求項7】請求項4において、演算された炭素ラジカ

た炭素ラジカルの絶対値密度出力装置。

【請求項8】請求項4において、演算された炭素ラジカルの絶対値密度に基づいて陰及び陽電極間に印加される電力を可変する制御手段を設けた炭素ラジカルの絶対値密度出力装置。

【請求項9】請求項4において、容器内のプラズマ中に 炭素原子を含有した炭素材料を配置し、該炭素材料から 放出される炭素ラジカルからの炭素ラジカル光線により 炭素ラジカルの吸収率を測定可能にした炭素ラジカルの 絶対値密度出力装置。

【請求項10】請求項4において、発光線発生装置はプラズマ中の炭素ラジカルから発光する炭素ラジカル光線をプラズマに照射可能にして構成した炭素ラジカルの絶対値密度出力装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、容器内に導入される炭素原子を含んだ原料ガス中の炭素ラジカル密度を 絶対値で出力する炭素ラジカルの絶対値出力装置に関する。 においては、反応プラズマ中の炭素ラジカルにより半導体ウェハーやLCD用ガラス基板等の各種被処理体をエッチング処理したり、被処理体上に炭素ラジカルによるダイヤモンド薄膜等の炭素薄膜を成膜しているが、エッチング処理や成膜の加工精度が超微細化している現状においては、これらの処理を高速、高選択比、高精度に行う必要から反応プラズマ中の炭素ラジカル密度を高精度に制御することが不可欠になっている。

【0004】この欠点は、炭素ラジカルを絶対値として 求めることにより解決し得るが、炭素ラジカルの吸収率 から炭素ラジカルの絶対値密度を求めるには、現在の 処、炭素ラジカルの放射減衰率であるアインシュタイン A係数が不明なため、炭素ラジカルの絶対値密度を求め ることができなかった。

【0005】本発明は、上記した従来の欠点を解決するために発明されたものであり、その課題とする処は、炭素原子を含んだ原料ガス中における炭素ラジカルの密度を絶対値で確認することができ、炭素ラジカルの高精度制御を可能にする炭素ラジカルの絶対値出力装置を提供することにある。

[0006]

【問題点を解決するための手段】このため本発明は、容器内に導入される炭素原子を含んだ原料ガスに対し、発光線発生装置から波長296.7 nmの炭素ラジカル光線を照射して炭素ラジカル光線の透過量に基づいて測定された炭素ラジカルの吸収率から算出された吸収係数及び波長296.7 nmのアインシュタインA係数4.7×104 S-1から原料ガス中における炭素ラジカルの絶対値密度を演算する絶対値密度演算手段と、演算された炭素ラジカル密度を絶対値として出力する出力手段から構成される。

【〇〇〇7】そして容器内の炭素ラジカル密度を絶対値

[0008]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係る炭素ラジカルの絶対値密度出力装置を、高周波によりプラズマを発生させる誘導結合型プラズマ処理装置に実施した実施形態に基づいて説明する。

【0009】実施形態

図1はプラズマ処理装置の概略を示す概略断面図である。

【 O O 1 O 】図2は発光線発生装置の概略を示す概略断面図である。

【0011】図3はプラズマ処理装置の制御概略を示す説明図である。

【0012】成膜装置或いはエッチング処理装置としてプラズマ処理装置1の処理室を構成する真空容器3上的には石英管により構成された放電室5が設けられ、該放電室5の周囲には高周波電源7に接続された高周波で行って接続された高周波でで接続された高周波でである。この高周波でよりられている。この高周波でよりられている。高周波でよりられている。高周波でよりるの間には周方向に多数のスリド電室5及び真空容器3内にプラズでを発生させる。放電室5と高周波でかけられている。又、放電室5は流水中に浸るが形成され、かつ接地された銅板等の静電シールドラでが形成され、かつ接地された銅板等の静電シールドラでは、該放電室5がエッチングされるのをいでいる。更に、真空容器3の外壁面には温度調整手段としてりまた。

【0013】尚、上記した高周波としてはRF帯域(13.56MHz)、VHF帯域(100MHz)或いはUHF帯域(500MHz)の何れであってもよく、又マイクロ波(2.45GHz)或いは直流電力によりプラズマを発生させてもよい。

【 0 0 1 4 】放電室 5 の下部外周側に位置する真空容器 3 上部にはヘリウムガス、アルゴンガス等の反応性ガス と共にエッチング処理の場合にはフルオロカーボンガス (C x F x) 、又カーボン薄膜を成膜する場合に一酸化 炭素ガス (C O ガス) 等の炭素原子を含有した原料ガスを所定の流量で真空容器 3 内に導入するための導入口 1 3 が設けられている。該導入口 1 3 には反応性ガス供給源及び原料ガス供給源(何れも図示せず)が、パルスモータ 1 4 a・1 6 a により開度を数値制御可能なバルブ 1 4 b・1 6 b を設けて接続され、真空容器 3 内に導入 される反応性ガス及び原料ガスの量を調整可能にしている。

【0015】真空容器3内には電極としての載置台15が設けられ、該載置台15上には半導体ウェハーやLCD用ガラス基板等の被処理体17が、必要に応じて静電チャック19等の保持部材を介して載置される。載置台

加してマイナスのバイアスを生じさせている。又、真空容器3の下部には真空排気装置(図示せず)の排気管23が圧力可変バルブ24を介して接続され、導入口13から原料ガスを導入しながら排気管23から圧力可変バルブ24により調整された量の空気を排気して真空容器3及び放電室5における原料ガス圧を調整可能にしている。

【0016】尚、上記した静電チャック19は絶縁性薄膜間に電極(図示せず)を設け、該電極に直流電流を印加して被処理体17を静電吸着させて保持する。又、載置台15には液体窒素等の冷媒を循環させて冷却する冷却手段(図示せず)及び加熱するヒーター(図示せず)が必要に応じて設けられ、被処理体17を所望の温度に調節することができる。

【0017】真空容器3の側壁にはSiO2等からなる一対の窓25a・25bが相対して設けられ、一方の窓25aの外側には発光線発生装置27及基準発光線発生装置44が、又他方の窓25bの外側には発光線発生装置27から出射されて真空容器3内のプラズマ中を通過した炭素ラジカル光線を検出する発光線検出装置27な基準発光線発生装置44、発光線検出装置29な基準発光線発生装置44、発光線検出装置29な経費生装置27から出射される炭素ラジカル光線の強度に基づいてプラズマ中における炭素ラジカル光線の強度に基づいてプラズマ中における炭素ラジカルによる炭素ラジカル光線の吸収率を測定するものであり、測定された炭素ラジカルの吸収率に関するず一タは絶対値密度演算手段を構成する制御手段31へ転送される。

【0018】制御手段31は転送された炭素ラジカルの吸収率に基づいて式1から吸収係数を算出し、該吸収係数と後述するように測定された波長296.7nmの炭素ラジカル光線の放射減衰率であるアインシュタインA係数に基づいて式2から炭素ラジカルの絶対値密度を演算処理し、該絶対値密度を出力手段を構成するCRT、LCD等の表示装置32に表示したり、プリンター34により印字する。

【0019】又、制御手段31は演算された炭素ラジカルの絶対値密度に基づいて高周波アンテナ9に印加される高周波電力、載置台15に印加されるバイアス電圧を夫々制御したり、パルスモータ14a・16aを駆動制御して真空容器3に導入される反応性ガス及び原料ガスの導入量を夫々調整したり、高周波電源7を可変制御して高周波アンテナ9に印加される電力を制御したり、壁面ヒーター12により真空容器3の温度を調整してプラズマ反応度を制御したり、圧力可変バルブ24により真空容器3内の排気量を調整して内部の圧力を制御して真空容器3内の炭素ラジカル密度を一定化させる。

り、プリンター34で印字された炭素ラジカルの絶対密度を参照して原料ガスの導入量、高周波アンテナ9に印加される電力等を手動で調整制御してもよい。又、発光線発生装置27と基準発光線発生装置44及び発光線検出装置29の配置位置は炭素ラジカル光線が被処理体17の反応面の直上、例えば10mm上方を通過する位置が望ましい。

【0021】次に、発光線発生装置27及び基準発光線発生装置44を説明する。尚、図2は発光線発生装置27のみを示すが、基準発光線発生装置44も同様な構成であり、その詳細な説明を省略する。

【0022】発光線発生装置27(基準発光線発生装置 44)の円筒ケース33はステンレス等の金属製で、そ の先端開口には、例えば光が透過可能なSiO2等から なる窓35が取付けられている。該窓35の材質につい ては上記した窓25a・25bと同様に他の材質であっ てもよい。又、円筒ケース33内のガラス管37内には 電源(図示せず)に接続されたカーボン電極39が取付 けられ、窓35に相対するカーボン電極39の先端面に は凹部39aが形成されている。更に、円筒ケース33 の側壁にはガス導入口41及び真空排気装置(図示せ ず)に接続された排気口43が相対して設けられ、ガス 導入口41を介してアルゴンガス(Ar)と炭素原子及 び酸素原子を含む、例えばCOガスを所定の流量で円筒 ケース33内へ導入する一方、排気口43から排気して 円筒ケース33内のガス圧をほぼ一定に保つように構成 されている。

【0023】そしてカーボン電極39に電圧(例えば印加電圧400V、電流30mA)を印加すると、カーボン電極39先端面の凹部39aと窓35の間にプラズマが発生して炭素ラジカルを波長296.7 nmで発光させて炭素ラジカル光線を得ている。この炭素ラジカル光線は窓35を透過した後、窓25aとの間に配置されたレンズ36により平行光線になり、真空容器3内を通過して他方の窓25bに向かうように出射される。

【0024】尚、レンズ36と一方の窓25aの間に半透鏡40及びチョッパー42を夫々設け、半透鏡40により発光線発生装置27から出射された炭素ラジカル光線の光路を発光線検出装置29と基準発光線発生装置44に分散させると共にチョッパー42により発光線検出装置29に向かう炭素ラジカル光線をON-OFFさせる。又、他方の窓25bと発光線検出装置29の間にレンズ38を設け、他方の窓25bを透過した平行光線をスポット光に収束して発光線検出装置29に受光させるようにすればよい。

【 O O 2 5 】上記のように構成されたプラズマ処理装置 1により被処理体 1 7に成膜処理したり、エッチング処理したりする。即ち、被処理体 1 7に炭素薄膜を成膜す 原料ガスは高周波電界により反応性プラズマ化し、該反応性プラズマ内の炭素ラジカルを被処理体 1'7上に堆積してダイヤモンド薄膜、硬質炭素薄膜或いは炭化珪素薄膜等を形成させる。又、被処理体 1 7 をエッチング処理するには、導入口 1 3 からフルオロカーボンガス等の原料ガスを導入して上記と同様に反応性プラズマ化した状態でバイアス電源 2 1 から載置台 1 5 にバイアス電圧を印加すると、反応性プラズマ中の陽イオン化したFイオン、CF×イオン、炭素イオンを被処理体 1 7 に衝突させて被処理体 1 7 をエッチング処理する。

【0026】そして上記プラズマ処理装置1による成膜処理中或いはエッチング処理中においては高周波アンテナ9に印加される高周波電力を制御したり、載置台15に印加されるバイアス電圧を制御することにより成膜される薄膜の厚さを調整したり、エッチングの選択比、加工精度を調整するため、発光線発生装置27と基準発光線発生装置44及び発光線検出装置29により反応性プラズマ中における炭素ラジカルの吸収率 Ia / I0 を測定して炭素ラジカル密度を絶対値として得る。

 9に高周波電力を印加してプラズマ化した状態で、先ずチョッパー42を閉じた状態で該プラズマ中の炭素ラジカルから発光する炭素ラジカル光線の強度 I 1 を発光線検出装置 29により測定する。

【0028】次に、チョッパー42を開いた状態でプラズマ中における炭素ラジカルの発光強度 I_1 と発光線発生装置 27 から出射され、プラズマ中で一部が吸収された炭素ラジカル光線の強度 I_0 との和である強度 I_2 を測定する。そして強度 I_1 及び I_2 を測定している間中、常に基準発光線発生装置 44 により発光線発生装置 27 から出射される炭素ラジカル光線の強度 I_r を測定し、該強度 I_r と上記の式 I_{00} / I_{r0} で求められた強度比 α とにより発光線発生装置 27 から出射されるプラズマ中の炭素ラジカルに吸収されない場合に発光線検出まで中の炭素ラジカルの吸収率を測定する際の基準強度にする炭素ラジカルの吸収率を測定する際の基準強度にする。そして測定された上記各強度から、式(I_2 一 I_1) / I_0 によりプラズマ中における炭素ラジカルによる炭素ラジカル光線の吸収率 I_a / I_0 を求める。

【0029】次に、上記のようにして求められたプラズマ中における炭素ラジカルの吸収率 Ia / I0 から炭素ラジカルの絶対値密度を求める方法を説明する。

【0030】一般にプラズマ中における炭素ラジカルの 吸収率は以下の式1により求められる。

【0031】 【式1】

$$\frac{I_{1}}{I_{0}} = \frac{\int f_{1}(v) e x p \{-k_{0}L^{\bullet} f_{2}(v)\} dv}{\int f_{1}(v) dv}$$

 I_a / I_0 : 吸収率、 f_1 (ν): 炭素ラジカルのプロファイル f_2 (ν): プラズマ中の炭素ラジカルの吸収プロファイル、 ν : 周波数、L: 吸収長、 k_0 : 中心周波数の吸収係数

【0032】又、炭素ラジカルの絶対値密度は以下の式2により求められる。

[0033] [武2]

$$N = \frac{8 \pi v_0^2 g_1}{A C^2 g_2} \int k_0 f_2(v) dv$$

ν₀:中心周波数、g₁:下準位の統計重率、

g2:上準位の統計重率、c:光速、

N:下準位の密度、A:アインシュタインA係数

但し、炭素ラジカル光線が296.7nm の場合、 $g_1 = g_2 = 5$

タインA係数: Aが特定されていれば絶対値密度: Nを求めることができる。以下に波長296. ファかで2s $2p^3$ $5S_2 - 2s^2$ $2p^2$ $3P_2$ の炭素ラジカル光線のアインシュタインA係数の測定方法を説明する。

【0035】図4及び図5はアインシュタインA係数の 測定装置例を示す概略図である。

【0036】プラズマ反応器50の上部には大面積の永久磁石52が取付けられ、該永久磁石52は上面を流通する冷却水により冷却されている。又、プラズマ反応器50の上部側面にはマイクロ波アンテナ54が設けられ、該マイクロ波アンテナ54は3KHzでパルス変調され、デューティー比15%、300Wのマイクロ波電力を出力する。マイクロ波アンテナ54に相対するプラズマ反応器50の上部側面にはガス導入口56が設けられ、プラズマ反応器50内にCOガスを導入している。

【0037】一方、プラズマ反応器50の下部には排気装置(図示せず)の排気管58が接続され、上記ガス導入口56からCOガスを導入しながらプラズマ反応器50内におけるCOガスの圧力が0.8pa、フローレイトが200sccmとなるように調整する。

【0038】プラズマ反応器50の側面にはクォーツ窓60が設けられ、クォーツ窓60の外側には分光器62及び負荷抵抗が50Ωkの光電子増幅器64が設けられ、光電子増幅器64にはディジタルオシロスコープ66が接続されている。該ディジタルオシロスコープ66はプラズマ反応器50内に発生する炭素ラジカル光線の波形を測定する。

【0039】図6はプラズマ反応器50内のCOガス圧を0.8pa、フローレイトを200sccm、マイクロ波アンテナ54のマイクロ波電力を300Wに設定してプラズマ反応器50内にプラズマを発生させて波長296.7nmで炭素ラジカルを発光させた際における炭素ラジカル光線の放射波形を示すものであり、該放射波形の傾きから炭素ラジカル光線の放射減衰率が3.8×104 S-1であった。

【0040】図7はプラズマ反応器50内のCOガス圧を0.13~20paの範囲で変化させた際における炭素ラジカル光線の放射減衰率を示している。そしてCOガスの圧力が0.13~1.1paの範囲内では減衰率が±30%の範囲内でほぼ一定化し、その平均値が4.7×10 4 S $^{-1}$ であった。これにより上記波長296.7nmの炭素ラジカル光線のアインシュタインA係数を4.7×10 4 S $^{-1}$ とした。尚、上記計測はS $^{\prime}$ N比を改善するため、夫々のCOガス圧毎に50回測定した。【0041】プラズマ処理装置1の制御手段31は上記方法により求められたプラズマ中における炭素ラジカルの吸収率 1 a $^{\prime}$ 10に基づいて算出された吸収係数 1 0の吸収率 1 10に基づいて算出された吸収係数 1 10に基づいて見からは 1 10に基づいて見からない。

処理して表示装置32に表示させたり、プリンター34により印字させることにより作業者は真空容器3内におけるプラズマ中の炭素ラジカル密度を直接確認することができる。

【0042】更に、炭素ラジカル密度が変化した場合には高周波アンテナ9に印加される高周波電力や載置台15に印加されるバイアス電圧を制御してプラズマ中における炭素ラジカルの絶対値密度が一定化するように制御したり、パルスモータ14a・16aを数値制御してバルブ14b・16bの開度を調整し、真空容器3に導入される反応性ガス及び原料ガスの量を夫々制御したり、壁面ヒーター12を制御して真空容器3の温度を可変によりプラズマ反応度を制御したり、更に圧力可変バルブ24を制御して真空容器3内における原料ガスの圧力を調整して炭素ラジカル密度を高精度に一定化させることができる。

【0043】尚、高周波アンテナ9に印加される高周波電力や載置台15に印加されるバイアス電圧をフィードバック制御するための炭素ラジカルの絶対値密度基準値は、被処理体の種類、プロセスの種類、プロセス条件等によって大きく異なるため、これらの条件に応じてその都度、実験等により設定することが好ましい。

【0044】このように本実施形態によれば、エッチングや薄膜形成に重要な要素である反応性プラズマ中における炭素ラジカル密度を、測定された炭素ラジカル光線の吸収率に基づいて算出された吸収係及び予め求められたアインシュタインA係数から絶対値として算出して確認可能にする一方、演算された炭素ラジカルの絶対値密度に基づいて高周波アンテナ9に印加される高周波電力や立てではいて高周波アンテナ9に印加される高周波電力や立ちに印加されるバイアス電圧、真空容器3内に導入される原料ガス量、壁面ヒーター12により真空容器3の温度、圧力可変バルブ24により真空容器内の圧力をリアルタイムで制御して真空容器3内の炭素ラジカル密度をほぼ一定にし、高精度エッチング及び薄膜形成を可能にしている。

【0045】プラズマ中における炭素ラジカルの吸収率 測定方法に関する変更実施形態を以下に説明する。尚、 夫々の変更実施形態はプラズマ中における炭素ラジカル の吸収率を測定する際の変更実施形態であり、これら変 更実施形態により測定された吸収率により吸収係数を算 出して炭素ラジカルの絶対値密度を演算して表示装置3 2に表示したり、プリンター34により印字して確認可 能にする一方、演算された炭素ラジカルの絶対値密度に 基づいてプラズマ処理装置1をフィードバック制御して 炭素ラジカルを制御する事項については、実施形態の説 明と同様であり、その詳細な説明を省略する。

【0046】変更実施形態1

【0047】変更実施形態1は、発光線発生装置27を使用せずに真空容器3内にてプラズマ形成される炭素ラジカルから発光する炭素ラジカル光線をそのまま利用してプラズマ中における炭素ラジカルの吸収率を測定するものであり、実施形態と同一の構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【0048】即ち、窓25aの上方に位置する真空容器3の側壁には、例えば光が透過可能なSiO2等からなる窓51が設けられ、該窓51の外側には第1の反射鏡53が、又窓25aの外側には第2の反射鏡55が夫々配置され、真空容器3内に導入された原料ガスを反応プラズマ化した際に原料ガス中の炭素ラジカルから発光する炭素ラジカル光線を窓51を介して真空容器3の外部へ取出した後、第1及び第2の反射鏡53・55により窓25aを介して再び真空容器3内のプラズマに向けて出射するように反射させて発光線検出装置29に入射させてその入射強度I1を計測する。

【0049】その際、例えば第1反射鏡53と第2反射鏡55の間にチョッパー57を設け、先ずチョッパー57を閉じて両者間の光路を遮断した状態で被検出体17の上方に生成しているプラズマ中における炭素ラジカルの発光強度を発光線検出装置29により計測して基準発光強度Iref.とし、次にチョッパー57を開いてプラズマ中から取出された炭素ラジカル光線を第1及び第2反射鏡53・55を介してプラズマ中に照射して発光線検出装置29に入射させて入射強度I1を計測する。そしてこれら入射強度Iref.とI1とによりプラズマ中における炭素ラジカルによる炭素ラジカル光線の吸収率

[(I₁ - I_{ref.}) / I_{ref.}] × 100を測定する。

【0050】変更実施形態2

図9はスパッタ処理装置の概略を示す概略断面図であり、実施形態と同一の部材については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【0051】成膜及びエッチング処理装置を構成するスパッタ処理装置71の真空容器73内には上部電極75及び下部電極77が所要の間隔をおいて相対配置され、上部電極75に原料ガス材料としての無定形炭素79を、又下部電極77にシリコン基板等の被処理体17を夫々設ける。下部電極77にはヒーター(図示せず)が内蔵され、室温から約600℃の範囲で温度制御可能になっている。本変更実施形態2では下部電極77の温度を室温に設定した。

【0052】そして導入口13からアルゴンガスと水素ガスを所定の流量で導入しながら排気管23から排気して真空容器73内を所要のガス圧に保ちながら上部電極75に、例えば13.56MHzの高周波を印加して下部電極77との間にアルゴンと水素の混合ガスのプラズマを発生させると、上部電極75に生じる直流電圧によ

7上に堆積し、硬質炭素薄膜を成膜させる。

【 0 0 5 3 】 その際、上記した実施形態の測定方法と同様に真空容器 7 3 の一方に配置された発光線発生装置 2 7 から出射される炭素ラジカル光線を、真空容器 7 3 内のプラズマを通過させて相対配置された発光線検出装置 2 9 へ出射し、プラズマ中における炭素ラジカルによる炭素ラジカル光線の吸収量により炭素ラジカルの吸収率を測定する。

【0054】変更実施形態3

図10はレーザアブレーション処理装置の概略を示す概略断面図であり、実施形態と同一の部材については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【0055】成膜及びエッチング処理装置を構成するレーザアブレーション処理装置81における真空容器83内の上部には原料ガス材料としての無定形炭素85が、又下部にはシリコン基板等の被処理体17を載置する載置台87が所要の間隔をおいて配置されている。又、真空容器83の外部には窓89を介して無定形炭素85にレーザ光を照射するレーザ発生装置91が設けられている。載置台87にはヒーター(図示せず)が内蔵され、室温から約600℃の範囲で温度制御可能になっている。本変更実施形態3では載置台87の温度を室温に設定した。

【0056】そして導入口13から所定流量の水素ガスを導入しながら排気管23から排気して真空容器83内を、例えば10Paの所定のガス圧に保ちながらレーザ発生装置91から、例えば30nsのパルス幅でレンズにより10J/cm²のエネルギー密度に制御されたレーザ光を無定形炭素85に照射すると、該レーザ光のエネルギーにより無定形炭素85を蒸発、アブレートさせて炭素のクラスター粒子或いは炭素ラジカルを放出させて発光柱(プルーム)92を形成し、被処理体17上に炭素のクラスター粒子を堆積させて硬質炭素薄膜を成膜させる。

【0057】その際、上記した実施形態の測定方法と同様に真空容器83の一方に配置された発光線発生装置27から出射される炭素ラジカル光線を、真空容器83内に発生している発光柱92或いは被処理体17の上方を通過させた後に発光線検出装置29に入射させて発光柱92中或いは被処理体17上方における炭素のクラスター粒子による炭素ラジカル光線の吸収量によりクラスター及び炭素ラジカルの吸収率を測定する。

【0058】上記した実施形態及び変更実施形態1~3において炭素ラジカルの吸収率を測定する方法としては、高周波アンテナ9に印加される高周波電力或いはレーザ発生装置91によるレーザ光の出力を所望のデューティにパルス変調し、該パルスがLOW(オフ)のとき、従って非プラズマ状態或いは非発光柱状態のとき、

ルスがHIGH(オン)のとき、従ってプラズマ状態或いは発光柱状態のとき、発光線検出装置29に入射される炭素ラジカル光線の強度に計測してプラズマ中或いは発光柱92中の炭素ラジカルによる炭素ラジカル光線の吸収量を演算する処理を繰返して測定すればよい。これにより発光線発生装置27から出射される炭素ラジカルによる炭素ラジカル光線の吸収率を高精度に測定することができる。

【0059】又、そのオン、オフは例えば周期100m秒においてオン50m秒、オフ50m秒程度でパルス変調放電を行っている。この場合においても、発光線発生装置27の前段にチョッパーを設け、チョッパー出力をトリガーにして信号を演算してもよい。更に、発光線発生装置27から出射される炭素ラジカル光線の発生直後の光をチョッパーによりオン・オフ変調し、この変調した光を出射してプラズマ或いは発光柱92を透過した光をチョッパーの周期に同期させて位相検波或いはこれをトリガとして演算してもよい。

【0060】又、発光線発生装置27は、プラズマ中の 炭素ラジカルから該炭素ラジカルに吸収可能な波長の光 に発光させる構成としたが、本発明においては、例えば 炭素ラジカルに吸収可能な波長の光をアーク放電等により発光させるものであってもよい。

【0061】更に、上記説明はプラズマ中において被処理体に炭素ラジカルを成膜したり、炭素原子でエッチング処理する際に、プラズマ中における炭素ラジカルの吸収率を測定して吸収係数を求め、該吸収係数と予め求められたアインシュタインA係数により炭素ラジカルの絶対値密度を演算して出力するものとしたが、本発明はプラズマ中における成膜処理やエッチング処理に限定されるものではなく、容器中に導入される排気ガス等の気体

中における炭素濃度を絶対値として出力する技術にも適用できる。

[0062]

【発明の効果】このため本発明は、炭素原子を含んだ原料ガス中における炭素ラジカルの密度を絶対値で確認することができ、炭素ラジカルの高精度制御を可能にしている。

【図面の簡単な説明】

【図1】プラズマ処理装置の概略を示す概略断面図である。

【図2】発光線発生装置の概略を示す概略断面図である。

【図3】プラズマ処理装置の制御概略を示す説明図である。

【図4】アインシュタインA係数の測定装置例を示す概略図である。

【図5】アインシュタインA係数の測定装置例を示す概略図である。

【図6】炭素ラジカル光の放射波形図である。

【図7】炭素ラジカル光の放射減衰率を示すグラフである。

【図8】プラズマ処理装置の概略を示す概略断面図である。

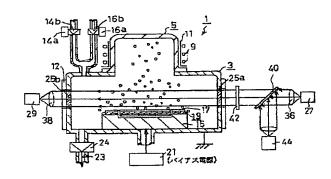
【図9】スパッタ処理装置の概略を示す概略断面図である。

【図10】レーザアブレーション処理装置の概略を示す 概略断面図である。

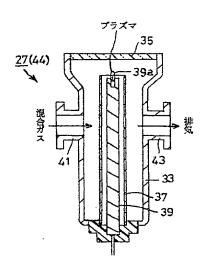
【符号の説明】

3 真空容器、27 発光線発生装置、31 吸収率測 定手段としての制御手段、32 絶対値密度測定手段と しての表示装置

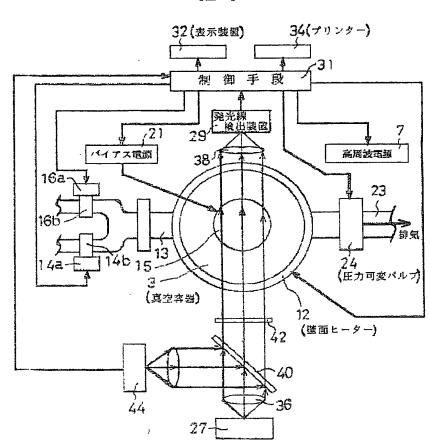


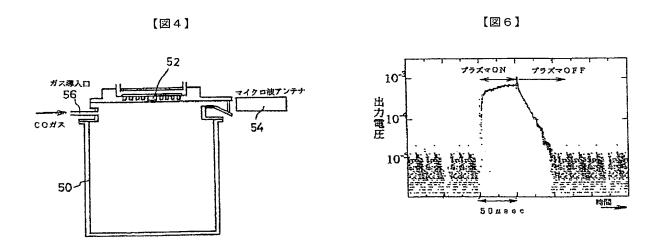


【図2】

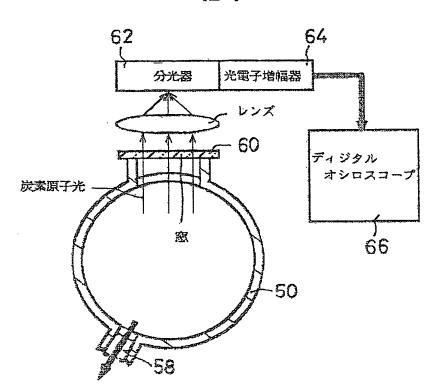


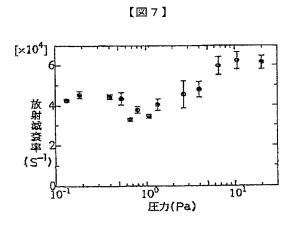
【図3】

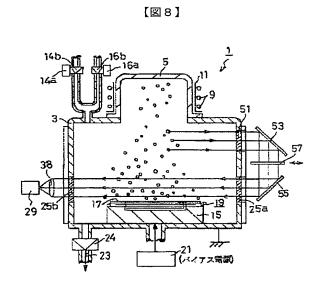




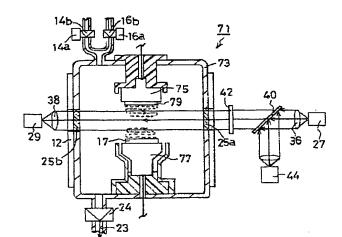
【図5】



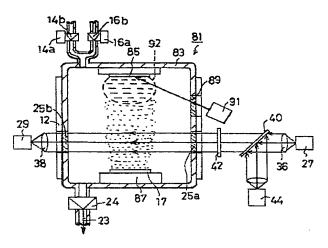




【図9】



[図10]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: ____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.